

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 是 否 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) (单位:元 币种:人民币)

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。(二)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明 (单位:元 币种:人民币)

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 5 columns: 项目, 变动比例(%) (单位:元 币种:人民币)

(一) 股东信息 (二) 控股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 适用 不适用 (二) 财务报表

合并资产负债表 2022年9月30日

编制单位:苏州晶方半导体科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2022 第三季度报告

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减变动幅度(%) (单位:元 币种:人民币)

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会 2022年10月28日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2022-048

苏州晶方半导体科技股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议于2022年10月28日以通讯和邮件方式发出通知，于2022年10月28日在公司会议室召开。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于公司与产业基金对外投资暨关联交易的议案》

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会审议的《关于公司与产业基金对外投资暨关联交易的议案》发表了独立意见。

四、备查文件目录 1.第五届董事会第三次临时会议决议公告 2.独立董事对第五届董事会第三次临时会议审议事项的独立意见

五、其他 特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会 2022年10月31日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2022-050

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于公司及产业基金对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资事项概述 为积极布局车用半导体前沿技术，有效把握三代半导体相关技术的产业发展机遇，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）与以色列VisiC Technologies Ltd.（以下简称“VisiC公司”）洽谈股权投资合作。

二、晶方半导体产业基金基本情况 (一) 本次增资前基本情况 名称:苏州晶方半导体集成电路产业基金合伙企业(有限合伙)

(二) 本次新增认缴出资基本情况 本次公司、东昊产业基金、鼎太股权投资、农银国际、湖南三安将作为新的有限合伙人，伙增资晶方半导体产业基金，其中公司认缴出资人民币13,986万元。

(三) 本次新增认缴出资资金来源 本次新增认缴出资资金来源于公司自有资金、东昊产业基金、鼎太股权投资、农银国际、湖南三安等有限合伙人自有资金。

(四) 本次新增认缴出资对公司的影响 本次新增认缴出资将增加晶方半导体产业基金的资金实力，有利于晶方半导体产业基金更好地开展对外投资业务。

(五) 本次新增认缴出资的决策程序 本次新增认缴出资事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规及公司章程的规定。

(六) 本次新增认缴出资的后续安排 本次新增认缴出资事项完成后，公司将按照相关法律法规及公司章程的规定履行后续程序。

(七) 本次新增认缴出资的风险提示 本次新增认缴出资事项存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

(八) 其他 特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会 2022年10月31日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2022-049

苏州晶方半导体科技股份有限公司第五届监事会第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次临时会议于2022年10月28日以现场方式召开。

二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于公司与产业基金对外投资暨关联交易的议案》

三、独立董事意见 独立董事对本次监事会审议的《关于公司与产业基金对外投资暨关联交易的议案》发表了独立意见。

四、备查文件目录 1.第五届监事会第三次临时会议决议公告 2.独立董事对第五届监事会第三次临时会议审议事项的独立意见

五、其他 特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会 2022年10月31日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2022-051

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于实施建设产业园项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目概述 为进一步提升公司产业资源优势，持续做大做强，公司计划在自有经营地块上实施“半导体科创产业生态园”建设项目（以下简称“项目”），以推进公司的未来战略发展需求。

二、项目实施地点 项目实施地点:苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖基金小镇10栋206室

三、项目实施内容 项目实施内容:规划建设总面积约12万平方米，其中研发用房综合楼约3万平方米，厂房与生产配套楼约9万平方米

四、项目进展情况 项目自实施以来，进展顺利，目前已完成前期规划、设计、招标等工作。

五、其他 特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会 2022年10月31日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2022-052

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于实施建设产业园项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目概述 为进一步提升公司产业资源优势，持续做大做强，公司计划在自有经营地块上实施“半导体科创产业生态园”建设项目（以下简称“项目”），以推进公司的未来战略发展需求。

二、项目实施地点 项目实施地点:苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖基金小镇10栋206室

三、项目实施内容 项目实施内容:规划建设总面积约12万平方米，其中研发用房综合楼约3万平方米，厂房与生产配套楼约9万平方米

四、项目进展情况 项目自实施以来，进展顺利，目前已完成前期规划、设计、招标等工作。

五、其他 特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会 2022年10月31日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2022-053

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于实施建设产业园项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目概述 为进一步提升公司产业资源优势，持续做大做强，公司计划在自有经营地块上实施“半导体科创产业生态园”建设项目（以下简称“项目”），以推进公司的未来战略发展需求。

二、项目实施地点 项目实施地点:苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖基金小镇10栋206室

三、项目实施内容 项目实施内容:规划建设总面积约12万平方米，其中研发用房综合楼约3万平方米，厂房与生产配套楼约9万平方米

四、项目进展情况 项目自实施以来，进展顺利，目前已完成前期规划、设计、招标等工作。

五、其他 特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会 2022年10月31日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2022-054

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于实施建设产业园项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目概述 为进一步提升公司产业资源优势，持续做大做强，公司计划在自有经营地块上实施“半导体科创产业生态园”建设项目（以下简称“项目”），以推进公司的未来战略发展需求。

二、项目实施地点 项目实施地点:苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖基金小镇10栋206室

三、项目实施内容 项目实施内容:规划建设总面积约12万平方米，其中研发用房综合楼约3万平方米，厂房与生产配套楼约9万平方米

四、项目进展情况 项目自实施以来，进展顺利，目前已完成前期规划、设计、招标等工作。

五、其他 特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会 2022年10月31日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2022-055

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于实施建设产业园项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目概述 为进一步提升公司产业资源优势，持续做大做强，公司计划在自有经营地块上实施“半导体科创产业生态园”建设项目（以下简称“项目”），以推进公司的未来战略发展需求。